

報道関係者各位

〒145-0066
株式会社芳和システムデザイン
東京都大田区南雪谷 1-16-8
電話 (03) 5843-0026
FAX (03) 5715-0026
<http://www.houwa-js.co.jp>

プレスリリース

問合せ先:

e-mail: blead@houwa-js.co.jp

プレスリリース

2014 年 4 月 18 日

Beacon モジュール「BLEAD」提供開始のお知らせ

株式会社芳和システムデザイン(本社 東京都大田区、代表取締役 大崎芳貴)は、「iOS7」に搭載された近距離データ通信新機能「iBeacon®(アイビーコン)」に対応した、位置情報や近接通知などの単機能から、来店ポイントや電子決済まで行える、Beacon「BLEAD(ブリード)」の発売および、Beacon が正規のものか認証するセキュリティサービスの提供を開始します。

内蔵する Bluetooth チップにはホシデン株式会社製 Bluetooth Low Energy Module HRM1017(技適取得済)を使用し国内での利用が可能となっています。



BLEAD(ブリード)

～続く～

記

製品の概要

Beacon モジュールは、iOS(iOS7 以降)と Android(4.3 以降)で利用でき到達距離約 70m(出力は段階的に変更可能)に対応、直径 5cm 重量 50g と小型軽量で、コイン型電池 CR2450 を使用し、約1年バッテリー交換なしで動作するため、商業施設や交通機関などさまざまな用途でご使用いただけます。

2014 年 4 月 18 日より限定 2000 個でサンプル出荷を開始、2014 年 6 月より月産 1 万個で量産を開始します。

7月量産の多機能 BLE モジュールは、同じケースに、温度、湿度、加速度、角速度、照度、気圧及び近接センサを内蔵します。

第一段のサービス提供は、株式会社インフォシティ様（本社 東京都渋谷区 代表取締役 岩浪剛太）の「BeaconPLUS」ソリューションを予定しています。

製品仕様

- ・ サイズ:直径 50mm×高さ 16.3mm
- ・ 色:オフホワイト
- ・ 重量:約50g(CR2450 込み)
- ・ 到達距離:約 70m(出力は段階的に減衰可能)
- ・ 電源:CR2450 (1個付属)
- ・ 電池寿命:約1年
- ・ 製造会社:ホシデン株式会社様(本社 大阪府八尾市 代表取締役社長 古橋 健二)

販売価格

○お試しセット Beacon 4個 10,000円(税抜き)

○開発セット Beacon 3個 + 書き込み治具1個 20,000円(税抜き)

※サンプルコード付き、別途 J-Link LITE を購入する必要があります。

○量産版 Beacon 10個 15,000円(税抜き)

1000個以上は、メールにてお問い合わせください。

1万個以上の場合は納期に3ヶ月程度かかります、早めにご発注下さい。

月産10万個以上も対応可能です、ご相談下さい。

個人や少量でも販売致しますので、メールにてお問い合わせください。

出展情報

- ・2014年3月21日秋葉原にて開催された日本 Android の会主催の、ABC2014Spring で行われた第1回 OBFT (Open Beacon Field Trial)にて、試作品の Beacon を提供させて頂きました。
- ・今後開催予定の第2回 OBFT には、サンプル版を設置させて頂きますので、Beacon を購入せずにフィールドテストにて試験が可能です。
- ・ワイアレスジャパン2014年5月28日～30日に、ホシデン株式会社様(製造会社)と共同出展します。
- ・ワークスタイル変革EXPO2014年7月16日～18日に出席します。

各社の商標または登録商標

- ・「iOS」及び「iBeacon」は、Apple Inc.の登録商標です。
- ・「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・「Bluetooth」は、Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。
- ・「J-Link LITE」は、SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG の登録商標です。

お問い合わせ

連絡先 blead@houwa-js.co.jp までお願いします。

お電話でのお問い合わせはご遠慮下さい。

会社概要

- | | |
|------------|------------------------------|
| (1) 商号 | 株式会社芳和システムデザイン |
| (2) 代表者 | 大崎 芳貴 |
| (3) 本社所在地 | 東京都大田区南雪谷1-16-8 |
| (4) 設立年月日 | 2002年9月 |
| (5) 主な業務内容 | システム開発、パッケージ開発・販売、各種機器の製造・販売 |
| (6) 資本金 | 1,000万 |

以上